

HL-SMA-KWE-CJ-02

材质与表面处理(Materials & Plating)

序号(Serial)	零件名称(Part Name)	材质(Material)	表面处理(Plating)
1	壳体(Body)	黄铜(Brass)	镀金(Gold Plated)
2	绝缘子(Insulator)	聚四氟乙烯(PTFE)	
3	中心孔针(Contact Pin)	黄铜(Brass)	镀金(Gold Plated)

性能指标(Electrical)

1.特性阻抗(Impedence) : 50Ω

2.频率范围(Frequency) : DC-6GHz

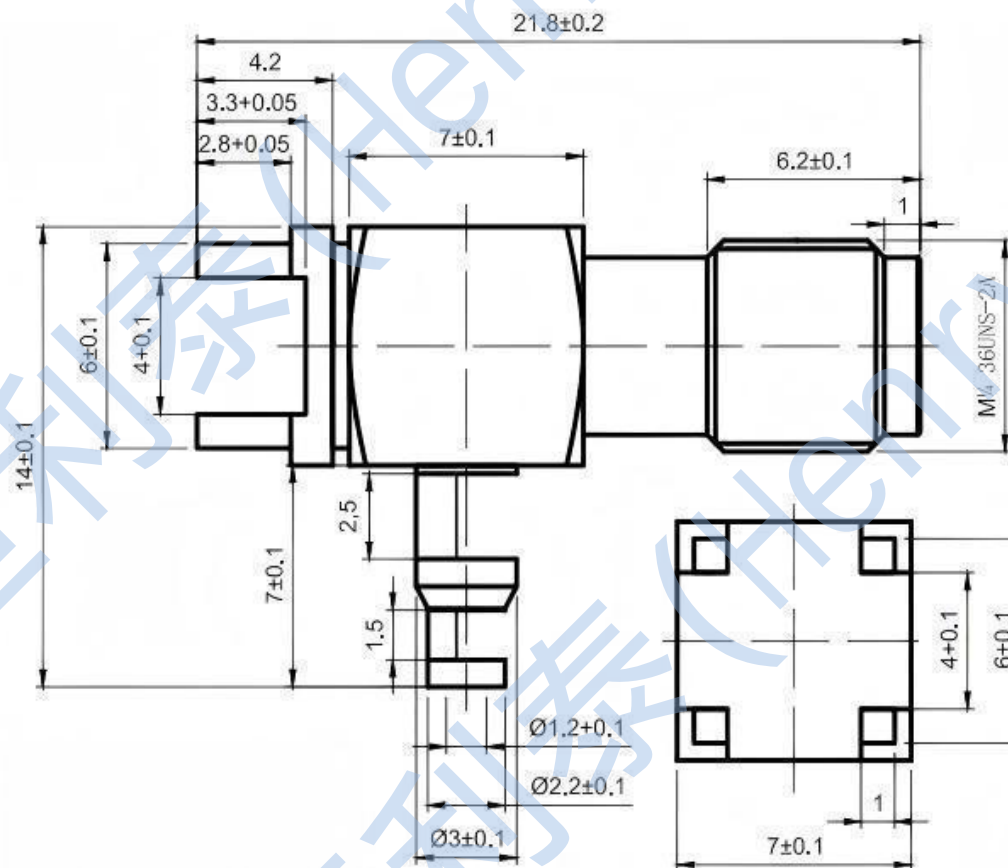
3.接触电阻：内导体(Center Contact Resistance) $\leq 3\text{m}\Omega$
接触电阻) $\leq 2\text{m}\Omega$

外导体(Outer

4.绝缘阻抗(Insulation Resistance) : $\geq 5000\text{M}\Omega$

5.介质耐压(Dielectric Withstanding Voltage) : 750V(Volts RMS)

6.驻波比(VSWR) : ≤ 1.25



 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

						 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		重量	比例	HL-SMA-KWE-CJ-02
设计			标准化							
校核			工艺							
主管设计			审核							
			批准			共1张	第1张	版本	替代	

一般公差(单位: mm)

X.	± 0.3
.X	± 0.2
.XX	± 0.1